

第96回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時：平成 22 年 12 月 10 日(金) 10:30～16:30

場 所：自動車会館（東京 市ヶ谷）

	時 間	題 目	講 演 者
平成 22 年 12 月 10 日 (金)	司 会 森 郁夫		
	10:30～11:15	『SiCパワーデバイスの実装技術』	(独)産業技術総合研究所 ○佐藤 弘、松井康平、谷本 智、 郎 豊群、佐藤伸二、仲川 博、 山口 浩、奥村 元
	11:15～12:00	『新しい炭素／セラミック複合材料 AlN／CBCについて』	大阪大学 ○東城哲朗、陳 衛武、宮本欽生
	12:00～13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～13:10	委 員 会 議 事	
	司 会 福本信次		
	13:10～13:55	『高耐熱パワーモジュールの実現に向けた 熱疲労信頼性評価技術』	日産自動車(株) ○山際正憲
	13:55～14:40	『厚銅貼り窒化珪素回路基板』	日立金属(株) ○渡辺純一
	14:40～15:00	休 憩	
	司 会 日下正広		
	15:00～15:45	『銅と錫の固相界面現象の機構と 超音波接合により形成された特異界面』	大阪大学 ○前田将克、高橋康夫
	15:45～16:30	『パワーモジュール用高放熱樹脂材料』	三菱電機(株) ○山本 圭、正木元基、三村研史 西村 隆

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。